## (19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平6-36994

(43)公開日 平成6年(1994)2月10日

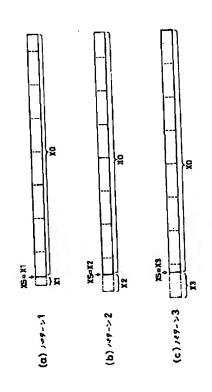
(51) Int.Cl. <sup>5</sup>	識別記号	庁内盛理番号	FΙ	技術表示箇所
H 0 1 L 21/027		9018-2K		
G 0 2 B 5/18	T 0 4	9018-2K 9122-2H		
G03F 7/20	5 0 4	9122-2F1 8831-4M	нол	21/30 3 4 1 J
		0001 4101	HOIL	21, 00
			5	審査請求 未請求 請求項の数4(全 9 頁)
(21)出願番号	特願平4-209541		(71)出願人	000004226
				日本電信電話株式会社
(22)出願日	平成4年(1992)7月15日			東京都千代田区内幸町一丁目1番6号
			(72)発明者	玉村 敏昭
				東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日
				本電信電話株式会社内
			(72)発明者	西田 敏夫
				東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日
				本電信電話株式会社内
			(74)代理人	弁理士 山川 政樹

## (54) 【発明の名称】 回折格子作製方法

## (57) 【要約】

【目的】 回折格子パターンのピッチの均一性の向上を図り、高精度の回折格子を得る。

【構成】 全体の回折格子パターンの大きさは一定とし、描画位置座標データの開始座標XSをパターン1,パターン2,パターン3でX1,X2,X3と変化させ、同時に、電子ピーム縁光データへの変換時のチップサイズを、回折格子パターンの設計長X0にそれぞれX1,X2,X3を加えた値とする。これら3種の回折格子描画パターンデータにより、同じステージ座標で(ステージ移動のない状態で)、重ねて縁光を行う。これにより、全く同じ位置に、主偏向器のDAコンバータの高次のピットの切り替え位置が変えられて、回折格子パターンが形成される。



10

問題点があった。

1

#### 【特許請求の範囲】

異なる描画位置座標データを有し実質的に同一のパターンとなる回折格子描画パターンデータを複数作成し、 これら回折格子描画パターンデータによりステージ移動

のない状態で重ねて露光を行って回折格子パターンを形成するようにしたことを特徴とする回折格子作製方法。

【請求項2】 ディジタル・アナログ変換器を用いた主偏向器と副偏向器とを備え、前記主偏向器により描画フィールド内の位置座標を指定し、前記描画フィールド内を前記副偏向器の走査範囲内で分割して、電子ビームを露光し、回折格子パターンを形成する回折格子作製方法において、

異なる副偏向器走査範囲を有し実質的に同一のパターンとなる回折格子描画パターンデータを複数作成し、

これら回折格子描画パターンデータによりステージ移動 のない状態で重ねて露光を行って回折格子パターンを形 20 成するようにしたことを特徴とする回折格子作製方法。

【請求項3】 ディジタル・アナログ変換器を用いた主偏向器と副偏向器とを備え、前記主偏向器により描画フィールド内の位置座標を指定し、前記描画フィールド内を前記副偏向器の走査範囲内で分割して、電子ビームを 露光し、回折格子パターンを形成する回折格子作製方法において、

異なる描画位置座標データおよび異なる副偏向器走査節 囲を有し実質的に同一のパターンとなる回折格子描画パターンデータを複数作成し、

これら回折格子描画パターンデータによりステージ移動 のない状態で重ねて露光を行って回折格子パターンを形 成するようにしたことを特徴とする回折格子作製方法。

【請求項4】 請求項2又は3において、各回折格子描 画パターンデータは、回折格子パターンの書き始めと書 き終わりの部分を除いて、副偏向器走査範囲の境界を共 有することがないことを特徴とする回折格子作製方法。

## 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】この発明は、電子ビーム技術によ 40 り回折格子を作製する回折格子作製方法に関するもので ある。

#### [0002]

【従来の技術】回折格子は、分布帰還型半導体レーザットの切り替え部分や、副偏(DFB-LD)、分布反射型半導体レーザ(DBR-LD)等の単一モード発振を可能とする半導体レーザが生じ、このため、描画した「や、グレーティングカップラ、分波器等の受動光素子に重要な構造である。従来、回折格子の作製には、そのピッチの制御性と大面積露光が可能な点から、紫外線を光がを光がまた。しかが、非常に高い精度の関とする2光束干渉露光法が主に使用されてきた。しかが、たきな障害となる。

しながら、この方法では、使用できるレジストの腹厚が 50nm程度と薄いため、ドライエッチング等の技術で 深い回折格子を形成することが困難であり、また、複数 のピッチを同一基板上に形成することが煩雑である等の

【0003】一方、電子ビーム解光技術は、解像度が高く、任意のパターンを形成できるため、ホトマスクや、種々のデバイス加工に使用されている。特に、電子ビームを微細径に収束すると、0.1  $\mu$ m以下の微細パターンを容易に形成できる。また、電子ビーム解光では、レジスト膜厚を大きくできること、複数のピッチを同一基板の所望の場所に形成できること、DFB-LDの単一縦モード発振に必要な位相シフト構造の導入が容易なことから、2光束干渉解光法に代わる回折格子作製技術として有力とされている。

【0004】電子ビーム露光により回折格子を形成する 際の最大の問題は、ピッチの均一性である。電子ピーム **露光装置の試料ステージの移動はレーザ干渉計により制** 御されているが、この精度は約20mm程度までしか上 げられない。このため、回折格子パターンを描画する際 は、試料ステージの移動を行わずに、すなわちステージ 移動のない状態で、ビームを走査できるフィールド内で パターンを形成する。この際、通常の収束電子ピームを 用いる露光装置では、描画速度の向上と位置精度の向上 のため、フィールド内の描画位置を決める主偏向器と、 個々のパターンを描画するための副偏向器を用い、図5 に示すように、描画フィールド1-a内を副偏向器の走 査範囲 1 - b内の区画に分けて露光する。主偏向器は高 ビット数で比較的低速で動作するDAコンパータ(ディ ジタル・アナログ変換器)で構成されている。副偏向器 *30* は比較的高速で低ビット数のDAコンバータで構成され ている。

#### [0005]

【発明が解決しようとする課題】このような装置構成で は、主偏向器のDAコンパータの高次のビットの切り替 え部分のつながりの精度と、主偏向器のDAコンパータ と副偏向器のDAコンバータの精度に僅かな差がある。 この精度の差は、その露光装置の最小データ単位程度に 抑えられており、通常のサブμm領域のパターン形成に は大きな影響を与えない。しかしながら、回折格子パタ ーンを描画する際に、回折格子パターン内での位相(ビ ッチ)の均一性を問題にするような場合は、この僅かな 精度の差により、主偏向器のDAコンパータの高次のビ ットの切り替え部分や、副偏向器走査範囲の境界(図 5 に示す1-c) において、パターンの位置に僅かなずれ が生じ、このため、描画した回折格子パターンにランダ ムな位相シフト構造が導入される結果になる。このよう な位相の不均一は、線幅の非常に狭いDFB-LD用回 折格子等、非常に高い精度の要求される回折格子の作製

【0006】本発明はこのような課題を解決するために なされたもので、その目的とするところは、電子ビーム を図光して回折格子パターンを形成するに際し、その回 折格子パターンのピッチの均一性の向上を図り、高精度 の回折格子を得ることにある。

#### [0007]

【課題を解決するための手段】このような目的を達成す るために、その第1発明(請求項1に係る発明)は、異 なる描画位置座標データを有し実質的に同一のパターン となる回折格子描画パターンデータを複数作成し、これ 10 ら回折格子描画パターンデータによりステージ移動のな い状態で重ねて露光を行って、回折格子パターンを形成 するようにしたものである。また、その第2発明(請求 項2に係る発明)は、異なる副偏向器走査範囲を有し実 質的に同一のパターンとなる回折格子描画パターンデー 夕を複数作成し、これら回折格子描画パターンデータに よりステージ移動のない状態で重ねて極光を行って、回 折格子パターンを形成するようにしたものである。ま た、その第3発明(請求項3に係る発明)は、異なる描 画位置座標データおよび異なる副偏向器走査範囲を有し 実質的に同一のパターンとなる回折格子描画パターンデ ータを複数作成し、これら回折格子描画パターンデータ によりステージ移動のない状態で重ねて露光を行って、 回折格子パターンを形成するようにしたものである。

[0008]

【作用】したがってこの発明によれば、その第1発明で は、主偏向器のディジタル・アナログ変換器の高次のビ ットの切り替え部でのパターンの位置ずれによるピッチ のずれを、平均化して、低減することが可能となる。ま ターンの位置ずれによるピッチのずれを、平均化して、 低減することが可能となる。また、その第3発明では、 主偏向器のディジタル・アナログ変換器の高次のビット の切り替え部および副偏向器走査範囲の境界でのパター ンの位置ずれによるピッチのずれを、平均化して、低減 することが可能となる。

[0009]

【実施例】以下、本発明に係る回折格子作製方法を詳細 に説明する。

について説明する。

【0011】例えば、16ピットのDAコンパータを主 偏向器として使用し、12ビットのDAコンパータを副 偏向器として使用するものとし、データの基本最小単位 を0.025μmとする。この際、主偏向器により走査 できる範囲は1638、4 μm角であり、副偏向器によ り走査できる範囲は102.4μm角である。

【0012】この全範囲を走査可能とした場合、主偏向 器のDAコンパータの高次のビットの切り替え部分は、

して409.6μmと1228.8μmの位置に、14 ピット目に対応して204.8 µm, 614.4 µm, 1024.0μm, 1433.6μmの位置に、13ビ ット目に対応して102. 4 μm, 307. 2 μm, 5 12.  $0 \mu m$ , 716.  $8 \mu m$ , 921.  $6 \mu m$ , 11 26. 4μm, 1331. 2μmの位置に現れる。主要 な位置ずれば上記の位置で生じるが、程度の差はあれ、 それ以下のピットの切り替え部分でも極微量ながら生じ

【0013】この主偏向器のDAコンパータによる位置 ずれを低減させるためには、上記の主要な位置ずれ発生 箇所が重ならないように、描画位置座標データを変え て、実質的に同一パターンとなる回折格子描画パターン データを複数作成し、これら回折格子描画パターンデー 夕によりステージ移動のない状態で重ねて露光を行うこ とが有効である。

【0014】図1はこのような回折格子描画パターンデ ータを作成する一例である。すなわち、全体の回折格子 バターンの大きさは一定とし、描画位置座標データの開 20 始座標XSをパターン1 (図1 (a)), パターン2 (図1 (b)), パターン3 (図1 (c)) でX1, X 2, X3と変化させ、同時に、電子ビーム解光データへ の変換時のチップサイズを、回折格子パターンの設計長 X0にそれぞれX1、X2、X3を加えた値とする。こ のようにすると、同一図形でありながら、主偏向器のD Aコンパータの高次のビットの切り替え位置が、図示破 線で代表して示すように変化する。これら3種の回折格 子描画パターンデータにより、同じステージ座標で(ス テージ移動のない状態で)、重ねて露光を行う。これに た、その第2発明では、副偏向器走査範囲の境界でのパ30より、全く同じ位置に、主偏向器のDAコンバータの高 次のピットの切り替え位置が変えられて、回折格子パタ ーンが形成される。

【0015】また、副偏向器走査範囲の境界でのパター ンの位置ずれを低減するためには、図2に示すように、 異なる副偏向器走査範囲3-b(3-b1~3-b3) を有し実質的に同一パターンとなる複数の回折格子描画 パターンデータにより、ステージ移動のない状態で重ね て露光を行うことが有効である。但し、この際に、複数 の回折格子描画パターンデータは、回折格子パターンの 【0010】先ず、実施例の説明に入る前に、その概要 40 書き始めと書き終わりの部分を除いて、副偏向器走査範 囲の境界を共有することがないように、回折格子描画パ ターンデータ作成時の副偏向器走査範囲を設定する必要 がある。なお、図2において、3-c (3-c1~3c 3) は、副偏向器走査範囲の境界である。

【0016】このようにすると、複数の回折格子描画パ ターンデータの中の1つの副偏向器走査範囲の境界で は、その位置に副偏向器走査範囲の境界を持たないパタ ーンと1回以上重ねて露光されるため、描画位置が平均 化されて、ずれが大幅に低減する。このような副偏向器 最高次が819、2μmの位置に、15ピット目に対応 50 走査範囲の境界を共有することのない複数の回折格子描 画パターンデータの設計は、描画する回折格子パターン のピッチ方向の副偏向器走査笕囲の値を、その値間の最 小公倍数に相当する寸法が、回折格子パターンの長さを 越えることがないように設定することにより可能とな

【0017】こらの位置ずれは、電子ピーム露光装置の 種類、また、同機種でもDAコンパータの性能の差、調 幣の違いにより、その大きさが異なる。従って、装置に 特徴的に現れるずれの補正を行う必要があるが、以上の 2種の低減方法を併せて実行することにより、上記の位 10 置ずれを同時に軽減することが可能である。すなわち、 異なる描画位置座標データを有し、かつ、異なる副偏向 器走査範囲を有する、実質的に同一のパターンとなる複 数の回折格子描画パターンデータにより、ステージ移動 のない状態で重ねて露光を行うことにより、位相すなわ ちピッチの揃った均一な回折格子パターンを恆子ピーム **露光により形成することができる。** 

【0018】なお、上述において、異なる回折格子描画 パターンデータによる露光の重ね回数は、多い方がピッ チの均一性が向上するが、重ね回数の増加に伴い露光に 20 要する時間(主に、データ処理時間)が増加し、また、 作成するデータファイル致も増加するので、3~5回程 度が最適であるが、2回でもある程度の効果が得られ る。

【0019】以下、具体的な実施例により、本発明を詳 細に説明する。

## 【0020】実施例1

電子ビーム露光装置として、JBX-5FE(日本電子 製)を用いて、回折格子を作製する例を述べる。上記装 置は、16ビットの主偏向器と、12ビットの副偏向器 30 とを備えている。データの基本最小単位は0.025μ mで、主偏向器により走査できる範囲は1600μm角 である。この中を、最大100μm, 最小25μmの節 囲を副偏向器により走査して、回折格子パターンを描画 する。回折格子パターンのピッチは、0.025μmの 基本最小単位の整数倍で設計し、偏向振り幅を微調整す ることにより、所望のピッチとする。本実施例では、 0. 24 µmピッチで、長さ1500 µm (走査座標の x方向とする)、幅100μm(走査座標のy方向とす る) の回折格子パターンを描画する。

[0021] st, 0.  $25 \mu m$  (0.  $025 \mu m O1$ 0ポイント分) ピッチで、0. 1μm露光部、0. 15  $\mu$ m未露光部とし、フィールドサイズを1562.5 $\mu$ mとする。主偏向器の高次のピットの切り替え時の位置 を変化させるため、回折格子パターンの書き始めのX座 標を0ポイント(図3(a):パターン11、設計座標 値0μm)、200ポイント(図3(b):パターン2 1、設計座標値 5 μm)、300ポイント(図3 (c): パターン31、設計座標値7.5 µm) とした 3種のパターンを設計し、チップサイズとフィールドサ 50 ねて露光されているために平均化され、観測可能な範囲

イズを共に、パターン11では1562.5 um、パタ ーン21では1567.5μm、パターン31では15 70μmとして、電子ビーム函光用データに変換する。 この場合、最高次のDAコンパータの切り替え位置は、 フィールドサイズの中心にくるので、パターン11では 781. 25 µm (31250ポイント)、パターン2 1では783. 75 μm (31350ポイント)、パタ ーン31では785μm(31400ポイント)にな る。なお、この場合、副偏向器の走査箆囲はx方向25 μm、y方向100μmで、共通にする。このように開 始点のずれをチップサイズで補償することにより、パタ ーン11,21,31の回折格子描画パターンデータ は、異なる描画位置座標データを有し実質的に同一のパ ターンとなる。

【0022】蘇光用の試料としては、InGsAaP 光ガイド 層を有する In P基板上に、ポジ型電子ビームレジスト (ZEP-520:日本ゼオン製) を0. 15μm塗布 したものを用いる。

【0023】まず、偏向振り幅を96%に調整し、ピッ チを0. 24μmとして、加速電圧25KV、電流値5 00pAの電子ピームによりレジスト感度21μC/c m²で、上記パターン11を描画する。続いて、異なる ステージ位置で、上記パターン11,21,31の3種 の回折格子描画パターンデータにより、それぞれレジス ト感度7μC/cm² でステージ移動のない状態で重ね て露光を行う。

【0024】上記の試料を、キシレンを用いて3分間現 像し、得られた回折格子パターンをノマルスキー微分干 渉光学顕微鏡で観測する。

【0025】この結果、パターン11のみで露光した回 折格子パターンには、回折格子パターンの中心である約 750 μmの位置に明確な線が観測され、更に、これよ り200μmおきに両側に、先の線よりコントラストは 低いものの線が見られた。これらは、14ピット目以上 の主偏向器のDAコンパータの切り替え位置に相当して おり、明らかに、この位置で回折格子パターンの位相が ずれていることを示している。更に、この回折格子パタ ーンを走査電子顕微鏡で観察した結果、中心の750μ mの位置ではピッチのずれが約0.02μm程度で、そ 40 の他の線に相当する部分では約0.01 μm弱のピッチ のずれがあることが明らかになった。

【0026】一方、パターン11,21,31の3種の 回折格子描画パターンデータにより重ねて露光を行った 回折格子パターンでは、ノマルスキー微分干渉光学顕微 鏡で観測した結果、先に見られた箇所での明瞭な位置ず れに相当する線は観測されなかった。この結果は、図3 (d) に示すパターン32のように、主偏向器のDAコ ンパータの高次のピットの切り替え位置での位相のずれ が、異なる描画位置座標データの回折格子パターンと重 以下に低減されていることを示している。

【0027】但し、これらの試料では、開始点より25 μmおきに、

蓉い線がノマルスキー微分干渉光学顕微鏡 で観測されている。これは、データ変換時の副偏向器走 査衛囲である25μmに相当し、副偏向器走査範囲の境 界で、回折格子パターンの位相がずれていることを示し ている。

## 【0028】実施例2

実施例1と同様に、長さ1500μm(走査座標のx方 向とする)、幅100μm(走査座標のy方向とする) の回折格子パターンを描画する。

[0029]  $\sharp \vec{v}$ , 0.  $25 \mu m$  (0.  $025 \mu m O1$ 0ポイント分) ピッチで、0. 1μm露光部、0. 15  $\mu$ m未露光部とし、フィールドサイズを $1562.5\mu$ mとする。副偏向器走査範囲を、y方向を100μmと 一定にし、x方向を79μm(図4(a):パターン4 1)、83 $\mu$ m (図4(b):パターン51)、89 $\mu$ m (図4 (c):パターン61)とした3種のパターン を設計し、電子ビーム解光用データに変換する。79μ  $m, 83 \mu m, 89 \mu m m m m m, 83 \mu m, 89 \mu m m m m m では、そのどの2つの最 20$ 小公倍数をとっても回折格子パターンの長さ1500μ mを越えるため、副偏向器走査範囲の境界を共有するこ とは有り得ない。

【0030】 **露光用の試料としては、InGsAaP 光ガイド** 層を有する In P基板上に、ポジ型電子ピームレジスト (ZEP-520:日本ゼオン製)を0.15μm塗布 したものを用いる。まず、偏向振り幅を96%に調整し T、ピッチを0.  $24 \mu$ mとしT、加速電圧25 KV、 電流値2nAの電子ビームによりレジスト感度21µC /cm<sup>2</sup> で、上記パターン41を描画する。続いて、異 30 なるステージ位置で、上記パターン41,51,61の 3種の回折格子描画パターンデータにより、それぞれレ ジスト感度7μC/cm² でステージ移動のない状態で 重ねて露光を行う。

【0031】上記の試料を、キシレンを用いて3分間現 像し、得られた回折格子パターンをノマルスキー微分干 渉光学顕微鏡で観測する。

【0032】この結果、パターン41のみで露光した回 折格子パターンには、約76μmおきに規則的に明確な 線が観測された。これは、79 mの副偏向器走査範囲 を偏向振り幅96%で描画する際の副偏向器走査範囲7 5. 8 4 μ m に相当し、明らかに、副偏向器走査範囲間 の境界で回折格子パターンの位相がずれていることを示 している。更に、この回折格子パターンを走査電子顕微 鏡で観察した結果、副偏向器走査箆囲間の境界でのピッ チのずれが約0.015μm程度であることが明らかに なった。

【0033】一方、パターン41,51,61の3種の 回折格子描画パターンデータにより重ねて露光を行った 回折格子パターンでは、ノマルスキー微分干渉光学顕微 50 【0039】この結果、実施例1, 2で見られたような

鏡で観測した結果、上記のような副偏向器走査範囲に相 当する規則的位相のずれを示すような明瞭な線は観測さ れなかった。また、このパターンの76μm近辺を走査 電子顕微鏡で観察した結果、有意なピッチのずれは観測 されなかった。この結果は、図4(d)に示すパターン 7 1 のように、副偏向器走査範囲の境界に相当するずれ が、異なる箆囲の回折格子パターンと重ねて軽光されて いるために平均化され、観測可能な筑囲以下に低減され ていることを示している。

【0034】但し、これらの回折格子パターンでは、ノ マルスキー微分干渉光学顕微鏡で、回折格子パターンの 中心である約750 µmの位置に明確な線が観測され、 更に、これより200μmおきに両側に、先の線よりコ ントラストは低いものの線が見られた。これらは、14 ビット目以上の主偏向器のDAコンパータの高次のビッ ト切り替え位置に相当しており、明らかに、この位置で 回折格子パターンの位相がずれていることを示してい

#### 【0035】 実施例3

実施例1と同様に、長さ1500μm(走査座標のx方 向とする)、幅100μm(走査座標のy方向とする) の回折格子パターンを描画する。

[0036]  $\sharp \vec{r}$ , 0. 25  $\mu$ m (0. 025  $\mu$ m 01 0ポイント分) ピッチで、0. 1 μm露光部、0. 15  $\mu$ m未解光部とし、フィールドサイズを $1562.5\mu$ mとする。回折格子パターンの費き始めのX座標をOポ イント(パターンA:設計座標値Oμm)、200ポイ ント (パターンB:設計座標値 $5\mu m$ )、300ポイント (パターンC:設計座標値7.5μm) とした3種の 回折格子描画パターンデータを設計する。パターンA, B. Cを電子ビーム露光用データに変換する際に、チッ プサイズを、各々、 $1562.5\mu m$ ,  $1567.5\mu$ m, 1570 μmとし、同時に副偏向器走査範囲を、y 方向は100μm-定とし、x方向を73μm, 89μ m, 97 $\mu$ mと変える。73 $\mu$ m, 89 $\mu$ m, 97 $\mu$ m の3種では、そのどの2つの最小公倍数をとっても回折 格子パターンの長さ1500μmを越えるため、副偏向 器走査笕囲の境界を共有することは有り得ない。

【0037】露光用の試料としては、InGsAaP 光ガイド 層を有する In P基板上に、ポジ型電子ピームレジスト (ZEP-520:日本ゼオン製)を0.15 µm塗布 したものを用いる。偏向振り幅を96%に調整し、ピッ チを0.24μmとして、加速電圧25KVで上記パタ ーンA、B、Cの3種の回折格子描画パターンデータに より、それぞれレジスト感度7μC/cm³でステージ 移動のない状態で重ねて蘇光を行う。

【0038】上記の試料を、キシレンを用いて3分間現 像し、得られた回折格子パターンをノマルスキー微分干 渉光学顕微鏡で観測する。

9

回折格子パターンの不連続を示すような線は全く見あたらず、また、走査電子顕微鏡で観察しても、ピッチのずれている箇所を見いだすことはできなかった。

#### [0040]

【発明の効果】以上説明したことから明らかなように本発明によれば、その第1発明では、主偏向器のディジタル・アナログ変換器の高次のピットの切り替え部でのパターンの位置ずれによるピッチのずれを平均化して低減することが可能となり、またその第2発明では、副偏向器走査範囲の境界でのパターンの位置ずれによるピッチ 10のずれを平均化して低減することが可能となり、またその第3発明では、主偏向器のディジタル・アナログ変換器の高次のピットの切り替え部および副偏向器走査範囲の境界でのパターンの位置ずれによるピッチのずれを平均化して低減することが可能となり、電子ビームを解光して回折格子パターンを形成するに際し、その回折格子パターンのピッチの均一性の向上を図り、高精度の回折格子と得ることができ、特に、線幅の狭い単一モード半導体レーザの実現に有効となることが期待される。

【図面の簡単な説明】

【図1】異なる描画位置座標データを有し実質的に同一 のパターンとなる複数の回折格子描画パターンデータを 用いて回折格子パターンを形成する方法を説明する図。

10

【図2】異なる副偏向器走査筑囲を有し実質的に同一の パターンとなる複数の回折格子描画パターンデータを用 いて回折格子パターンを形成する方法を説明する図。

【図3】実施例1を説明する図。

【図4】実施例2を説明する図。

10 【図5】描画フィールド内を副偏向器の走査範囲内の区画に分けて解光する状況を示す図。

#### 【符号の説明】

1-a 描画フィールド

1-b 副偏向器走査範囲

1-c 副偏向器走査範囲の境界

XS 描画位置座標データの開始座標

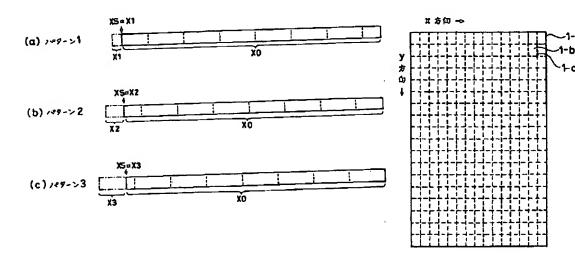
X0 回折格子パターンの設計長

3-b 副偏向器走查範囲

3-c 副偏向器走査範囲の境界

[図1]

[図5]



## 【図2】

